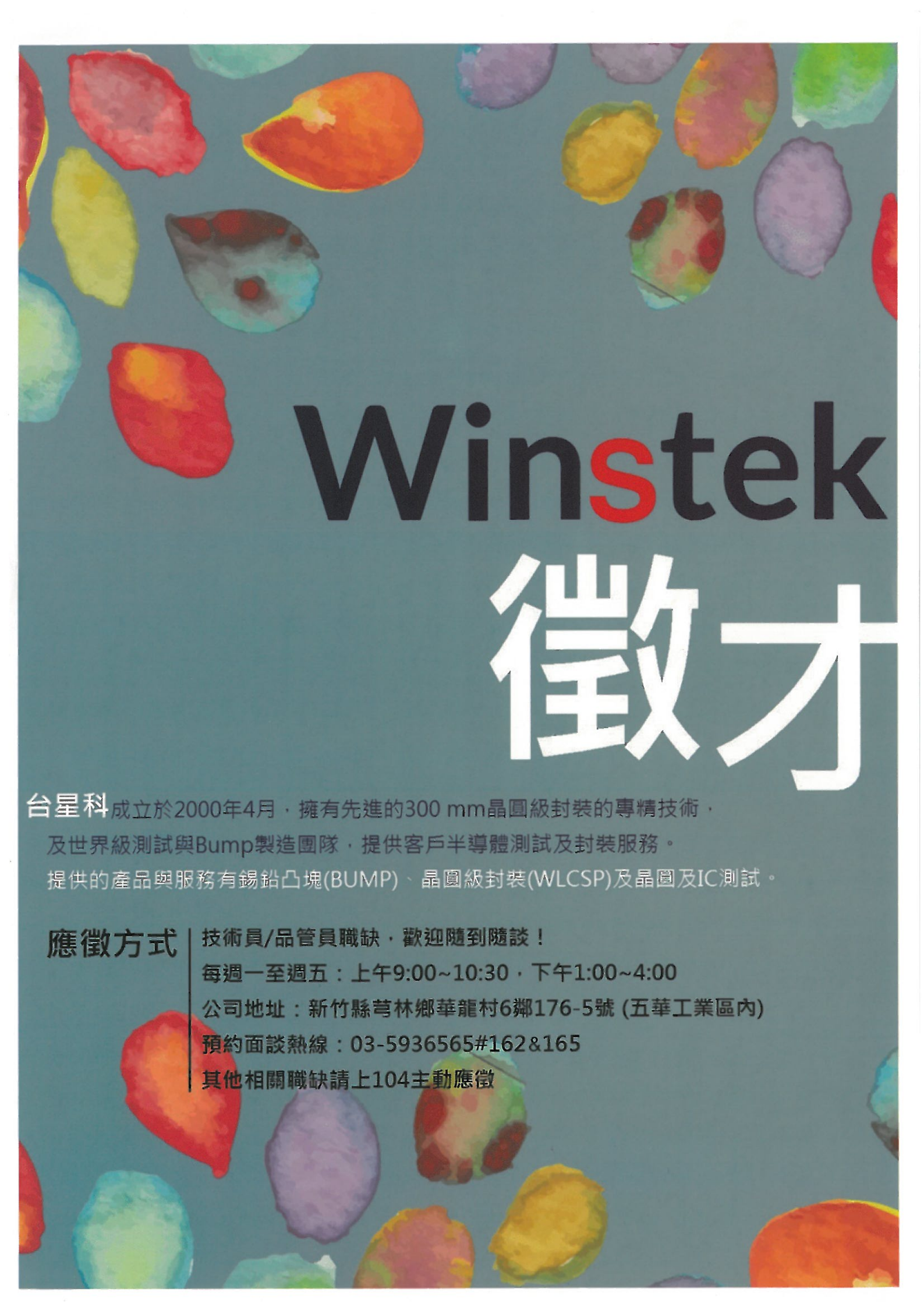




Winstek

徵才

台星科成立於2000年4月，擁有先進的300 mm晶圓級封裝的專精技術，
及世界級測試與Bump製造團隊，提供客戶半導體測試及封裝服務。
提供的產品與服務有錫鉛凸塊(BUMP)、晶圓級封裝(WLCSP)及晶圓及IC測試。

應徵方式

技術員/品管員職缺，歡迎隨到隨談！

每週一至週五：上午9:00~10:30，下午1:00~4:00

公司地址：新竹縣芎林鄉華龍村6鄰176-5號 (五華工業區內)

預約面談熱線：03-5936565#162&165

其他相關職缺請上104主動應徵